

半導体、エレクトロニクス分野の材料課題を解決！

お客様の製造プロセスに合わせた最適なソリューションを提供。

最適な材料選定から加工プロセスの構築まで、一貫したサービスで高品質な製品づくりを支援します。

強み STRENGTHS

- 製造プロセスに合わせた材料の提案と選定
- 接着信頼性向上のための各種表面処理技術
- 塗布、印刷、接着、成形などの各種加工技術
- 充実した試験、評価体制
- 顧客の製造プロセス認定実績
- 接着コンサルティングサービス

事例紹介 CASE STUDIES

事例1 半導体検査装置部品の接着信頼性向上

課題 高速な温度サイクル下において、発熱構造部品の接着層から冷媒が漏洩することで装置の信頼性が低下

- / 解決策 /
- 耐冷媒性を有する材料調査と選定
 - 接着剤と部材の熱膨張係数整合による低応力化
 - 接着信頼性を向上させる表面処理技術の開発
 - 品質工学を用いた外乱の影響を受けにくい加工プロセスの開発

—— 効果 ——

歩留まり100%の接着加工プロセス構築により装置信頼性が大幅に向上した。

事例2 ウェハ検査用アライメント治具の開発支援

課題 圧痕転写と消去を可能とする樹脂材料および均一成膜技術の開発

- / 解決策 /
- 粘弾性技術を用いた圧痕転写、消去可能な樹脂開発
 - メタルマスク印刷によるボイドレスかつ均一ベタ成膜の実現
 - 樹脂付き300mmウェハの高品質な個片化技術の開発

—— 効果 ——

粘弾性樹脂と均一成膜によって、圧痕転写と消去が可能となり、従来に比べて大幅にウェハの検査精度を向上させる高品質なアライメント治具を開発した。

